



日本高純度化学株式会社

(証券コード: 4973)

2015年3月期 決算説明資料



決算の概況

2015年3月期 通期の概況

電子部品業界の状況

- ハイエンドスマートフォンの新機種の販売が好調であり、年間を通じて牽引役となった。著しい伸びを示している中国スマートフォン向けも下支えとなり、これらに搭載される半導体や電子部品の需要が旺盛であった。また、サーバー用や車載用の電子部品も需要は堅調に推移した。
- パソコンや薄型テレビにおいては、年間を通じて需要が伸び悩み、生産調整も見受けられた。

当社決算の概況

- ハイエンドスマートフォン向けや車載向けマイクロコネクタ用硬質金めっき薬品は技術的な優位性から販売は好調に推移した。また、車載向けリードフレーム用パラジウムめっき薬品についても販売は好調に推移した。
- メモリ基板向けワイヤボンディング用純金めっき薬品については需要が増大し、減少傾向からやや増加傾向に転じたものの、パソコンやサーバ用金めっき薬品については省金化の影響を受け販売が落ち込んだ。

2015年3月期 決算概況

(単位：百万円、%)

決 算 期	2014/3期	2015/3期						2015/3期予想	
		1Q	2Q	3Q	4Q	通期合計		※2	達成率
						増減率			
売 上 高	9,189	2,339	2,743	2,354	2,118	9,556	4.0	9,600	99.5
営 業 利 益	970	315	281	311	199	1,109	14.2	1,050	105.6
経 常 利 益	1,025	343	287	344	200	1,176	14.8	1,100	106.9
純 利 益	670	240	182	231	114	768	14.6	720	106.7
1 株 当 た り 当期純利益※1	114.80円	41.37円	31.26円	39.68円	19.58円	131.87円	14.9	123.64円	106.7

※1 2014年4月1日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。そのため、当該株式分割が行われたと仮定して、1株当たり当期純利益を算定しております。

※2 2014年10月14日付で業績予想を修正しております。

メタル相場

Historical metal prices

メタル相場推移

Prices of copper, tin and nickel

銅、スズ、ニッケル価格

Copper

銅

Tin

スズ

Nickel

ニッケル

Prices of gold and palladium

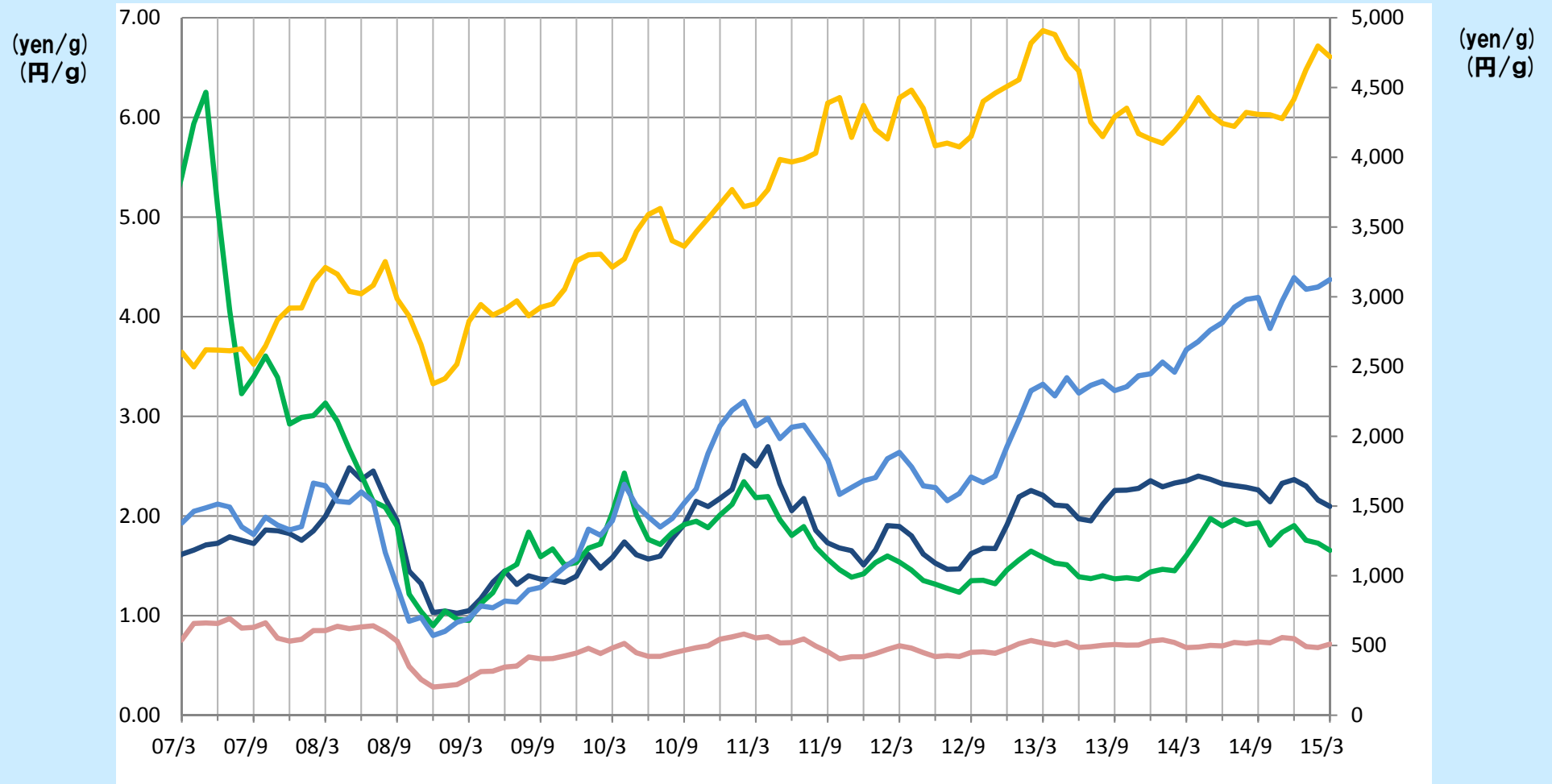
金(ゴールド)、パラジウム価格

Gold

金

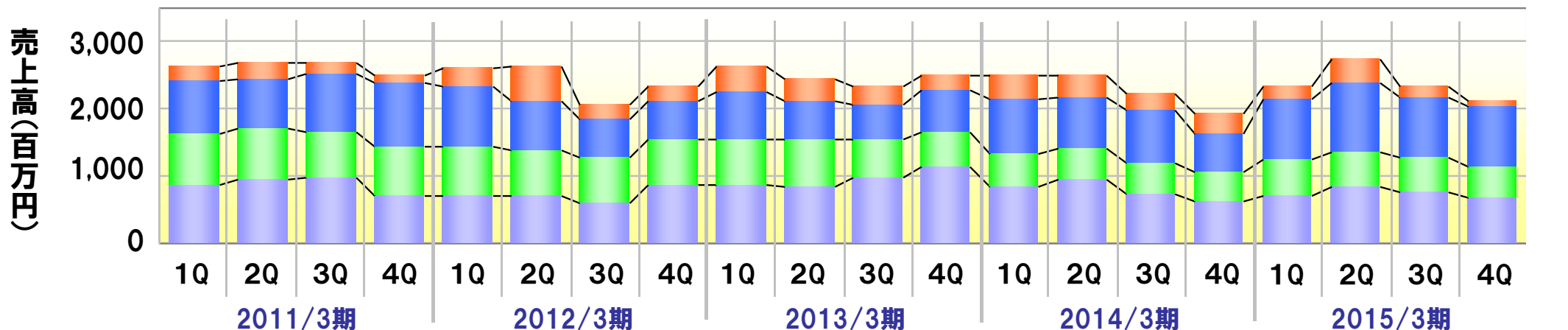
Palladium

パラジウム

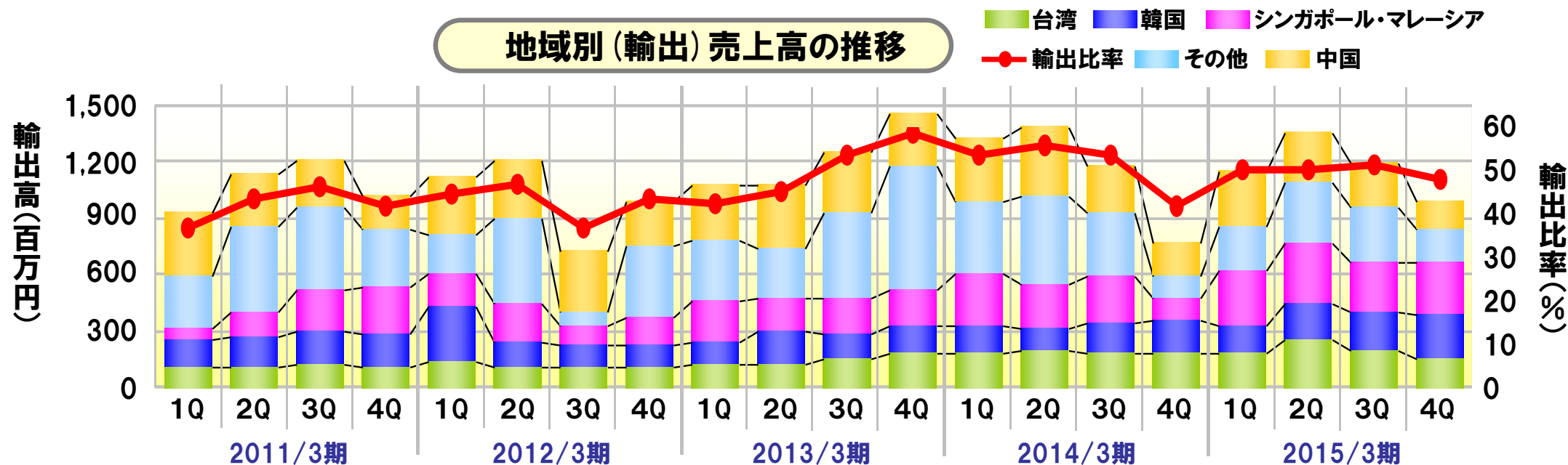


用途品目別および地域別売上高の推移

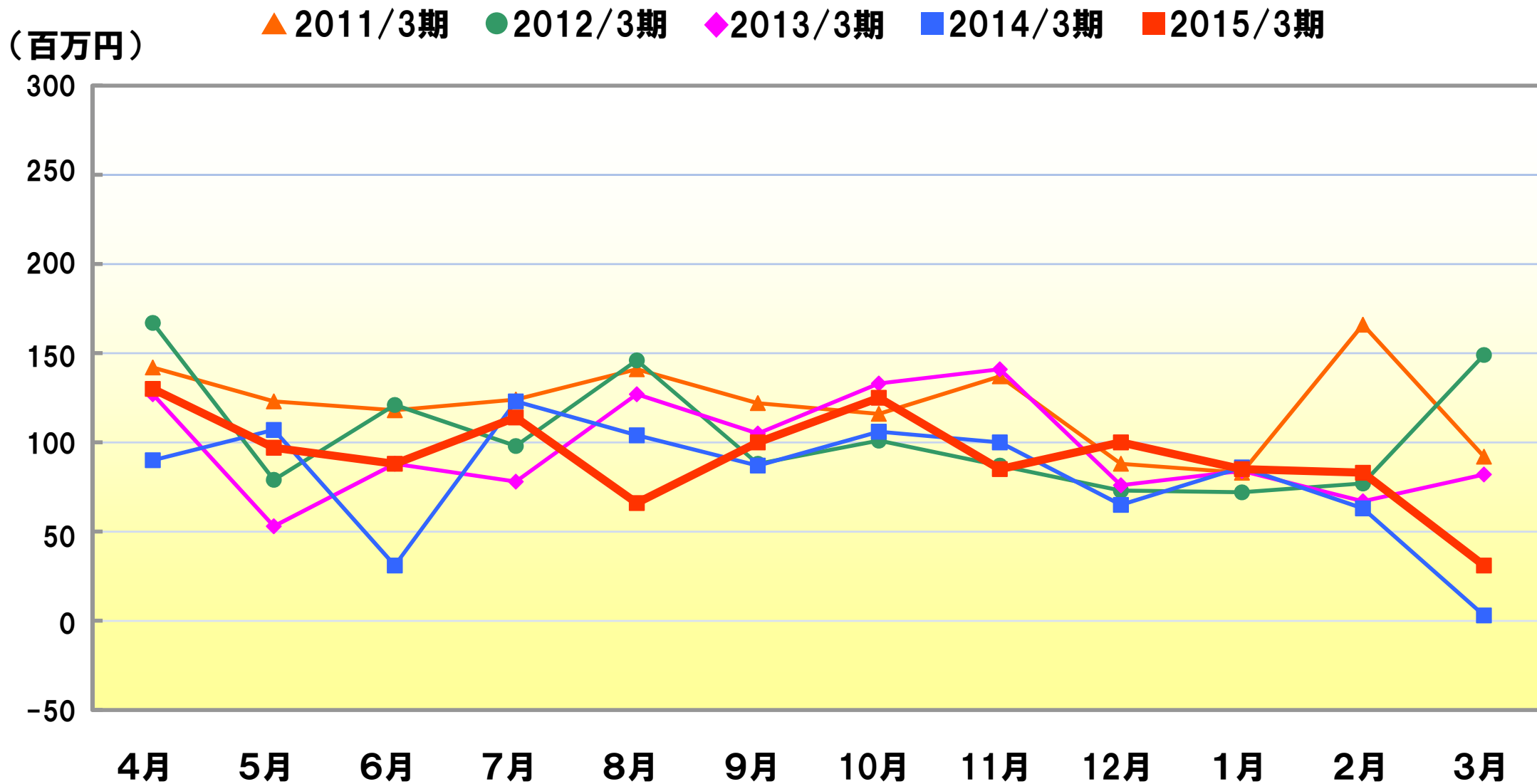
用途品目別売上高の推移



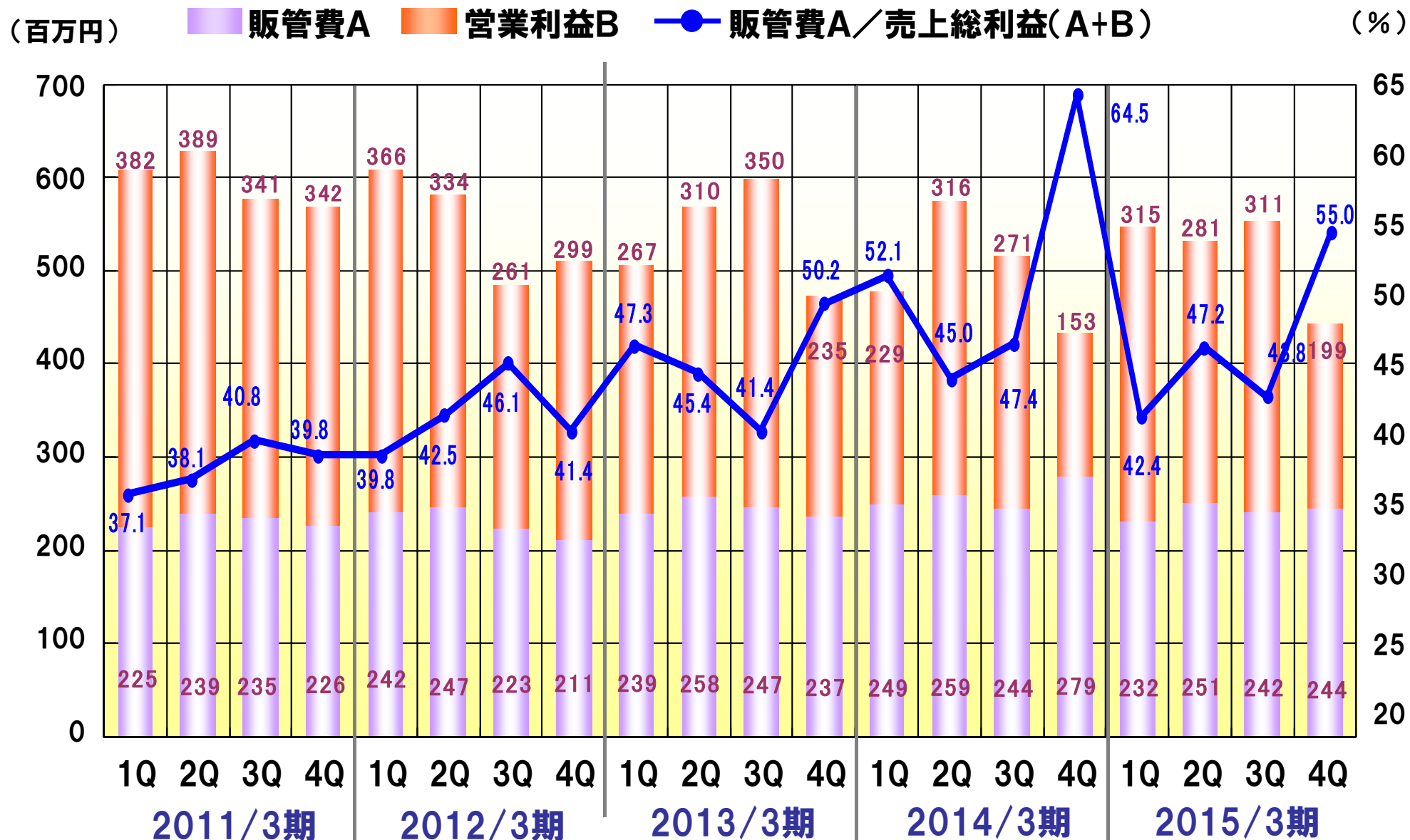
地域別(輸出)売上高の推移



営業利益の推移(5ヶ年)



販売管理費および営業利益の推移



株主還元について

■一株当たり配当金

(単位:円、%)

	通期	EPS ※	配当性向
2011/3期	8,000	143.89	55.6
2012/3期	8,000	114.37	70.0
2013/3期	8,000	134.20	59.4
2014/3期	8,000	114.80	69.5
2015/3期	80	131.87	60.7

※ 2014年4月1日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。
そのため、当該株式分割が行われたと仮定して、1株当たり当期純利益を算定しております。

2016年3月期 業績見通し

(単位:百万円、%)

決算期	2015/3期 第2四半期	2015/3期 通期	2016/3期 第2四半期		2016/3期 通期	
	実績	実績	予想	前年比	予想	前年比
売上高	5,082	9,556	4,970	△2.2	10,000	4.6
営業利益	597	1,109	630	5.5	1,270	14.5
経常利益	630	1,176	670	6.2	1,350	14.8
当期純利益	422	768	430	1.7	880	14.5
1株当たり当期純利益※	72.62	131.87円	73.69	1.5	150.82	14.4

※ 2014年4月1日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。

新製品の開発・拡販方針

- (1) 特長ある独自技術を使用**
→ “Protecting Agent”の適用
- (2) 省金化傾向に対応可能な製品の開発・拡販**
→ 厚膜めっきから薄膜めっきへ
- (3) 飛躍的な成長が見込める市場へ参入**
→ 電子部品から新分野へ

製品ラインアップと薄膜化対応

めっき方式		用途	製品ラインアップ
電解	純金 (99.99%以上)		TEMPERESISTシリーズ (厚膜めっき) ICパッケージのはんだ接続、ワイヤーボンディング用 EX フレキシブル基板対応 FX
	硬質金 (金合金)		OROBRIGHTシリーズ (局所めっき) コネクタ、フレキシブル基板の接続用 HS (Co合金) マイクロコネクタ対応 BAR7 (Co合金)、BAR (Ni) (Ni合金)
	電解Pd		PALLABRIGHTシリーズ (薄膜めっき) リードフレーム用 SST-L PPF薄膜化対応 NANO2
無電解	置換金		IM-GOLDシリーズ (薄膜めっき) 携帯基板のACF接続、はんだ接続用から新分野へ スマートフォン対応 IB2、CN-I、IB2X、OM2
	還元金		NEO GOLD (厚膜) から HY-GOLD (薄膜) へ サーバーやデスクトップPC向け MPUパッケージ用 NEO GOLD、HY-GOLD
	還元Pd		NEO PALLABRIGHTシリーズ (薄膜めっき) スマートフォン等のCSPパッケージ用 ネオパラブライต์、ネオパラブライต์2

“Protecting Agent”の適用例

“Protecting Agent”とは？

特定の金属に選択的に吸着し、めっき反応や皮膜物性をコントロールする水溶性有機化合物

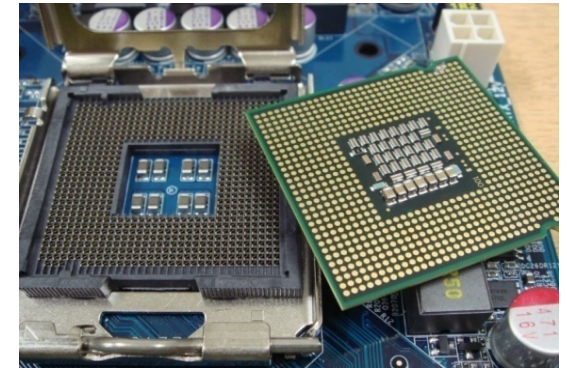
薄膜仕様の置換金めっき
(スマートフォン用、車載用プリント基板)

ENIGプロセス
無電解Ni+置換金

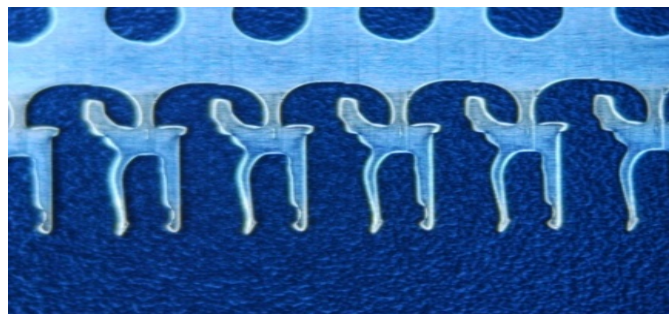
Ni表面の腐食抑制がカギ

Protecting Agent

薄膜仕様の還元金めっき
(LGA(ランドグリッドアレイ))



局所めっき
(マイクロコネクタ対応)

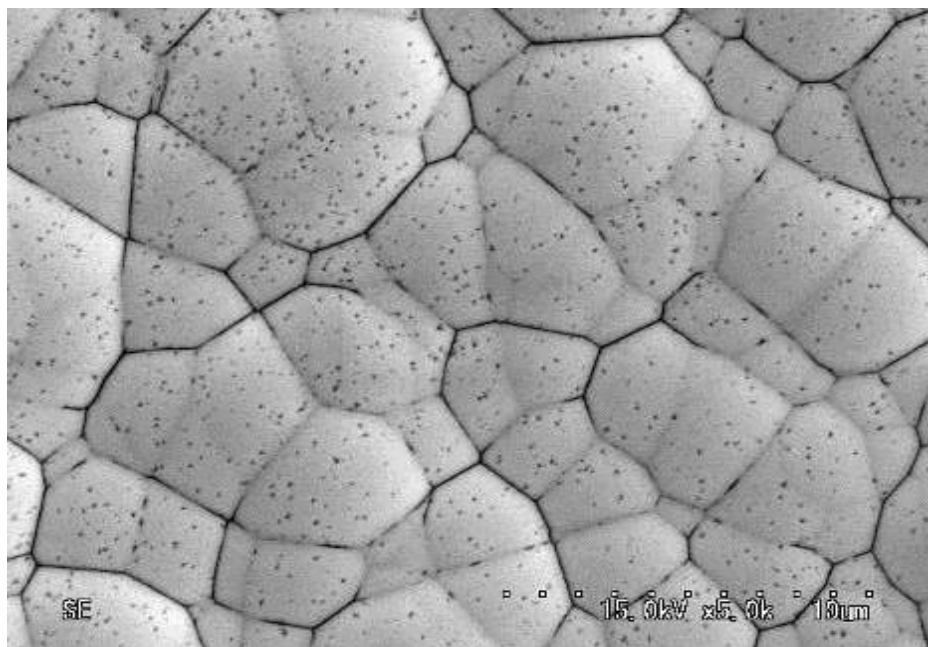


省金仕様下での貴金属めっき薬品の拡販(その1)

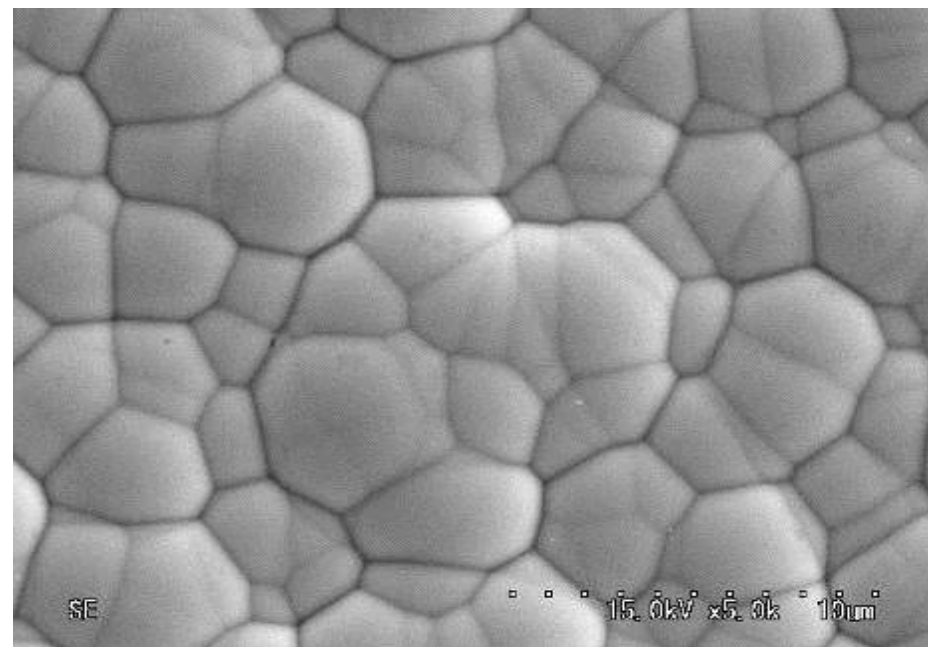
無電解Niめっきとの組合せ ～中国・東南アジア市場へ～

- ・特長あるENIG技術 → “Protecting Agent”による接合強度向上
- ・Niめっきメーカーとの協業 → ENIG薬品の一括納入
(車載・スマートフォン市場へ)

従来浴



“Protecting Agent”浴



“Protecting Agent”の適用により、Ni表面の腐食が抑制

省金仕様下での貴金属めっき薬品の拡販(その2)

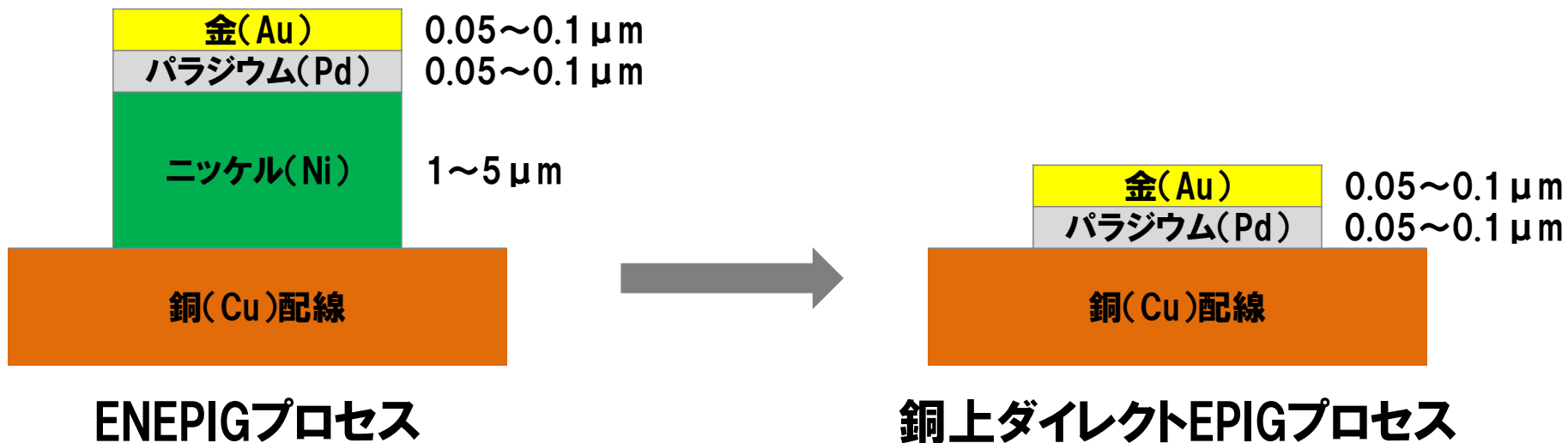
無電解Niめっきを省いたダイレクトめっき

～高速データ伝送、高密度配線へ～

ダイレクトめっき技術

ENIG → DIG(銅上ダイレクト金) (FPC等)

ENEPIG → 銅上ダイレクトEPIG(パラジウム/Au) (CSP等)



無電解ニッケルを省くことで、配線の高密度化が可能

デジタル家電・貴金属めっきの枠から脱却し、過去最高益に挑戦

貴金属めっきの主用途

- ・パッケージ
- ・プリント基板
- ・コネクタ
- ・リードフレーム

新分野・新基材

新分野・新基材

- ・車載
- ・セラミック
- ・プラスチック
- ・ウエハ

新要素技術

新要素技術

- ・合金めっき
Au-Ag、Au-Pd、Pd-Ni、Pd-Cu等
(センサー、水素社会)
- ・卑金属めっき
下地を侵食しない無電解Snめっき
(はんだボール代替)

注意事項・免責事項

当該資料で用いられている業績予想ならびに将来予測は、いずれも当社の事業に関連する業界の動向についての見通し、国内および諸外国の経済状況、ならびに為替レートの変動、その他の業績へ影響を与える要因について、2015年3月時点で入手可能な情報をもとにした予想を前提としています。

これらは、市況、競争状況、新製品およびサービスの導入およびその成否、ならびに情報通信関連産業の世界的な状況を含む多くの不確実な要因の影響を受けます。よって、実際の業績は配布資料および決算説明で用いる予想数値とは、大きく異なる場合があることをご了解いただきますようお願い致します。

この資料の著作権は日本高純度化学株式会社に帰属します。いかなる理由によっても、当社に許可なく資料を複製・配布することを禁じます。

お問い合わせ先

TEL. 03-3550-1048 FAX. 03-3550-1006

経営企画部

ir@netjpc.com <http://www.netjpc.com>